

Lasieranlagen für die Mikrobearbeitung

■ Lasieranlagen für die Mikrobearbeitung Beispiel: LMBS UV-015-001-xy400z200-IA



Merkmale:

- UV-Laser 335 nm
- Arbeitsfeld 350 mm x 350 mm
- Positioniergenauigkeit 1 µm
- Bearbeitungsdimensionen bis 5 µm
- automatische Bilderkennung mit Positionskorrektur

Anwendung:

- Herstellung von Fotoschablonen
- Pinholes und Pinhole-Arrays
- Extrem feine Metallmasken
- 3D-Bearbeitung in Silizium, Keramik, Metall
- Feinste Glasbearbeitung
- Beschriften, Bohren, Schneiden
- Mikrostrukturen

■ Lasieranlagen für die Mikrobearbeitung Beispiel: LMBS UV-150



Merkmale:

- UV-Laser 335 nm
- Arbeitsfeld 150 mm x 150 mm
- Positioniergenauigkeit 1,25 µm
- Bearbeitungsdimensionen bis 5 µm

Anwendung:

- Herstellung von Fotoschablonen
- Pinholes und Pinhole-Arrays
- Extrem feine Metallmasken
- 3D-Bearbeitung in Silizium, Keramik, Metall
- Feinste Glasbearbeitung
- Beschriften, Bohren, Schneiden
- Mikrostrukturen